

24년 스마트소형전자제품 개발·제조 지원 모집

□ 모집개요

- **(지원목적)** 스마트소형가전 스타트업 및 중소기업 제품의 개발, 제조에 이르는 과정을 공동개발 형태로 지원
 - * 스마트소형가전은 가볍고 작고 저가인 전자제품으로 중간기술기반 아이디어 소형가전
- **(지원내용)** 회로설계 → 부품선정 → 아트웍 → 보드제작 → 조립 → 펌웨어 → 하우징·케이스제작 → 전시 → 온라인콘텐츠제작 → 소비자 실증에 이르는 과정으로 본 공모를 통해 선정기업 지원

□ 지원사항

- **(지원방법)** 선정기업의 제품은 전자제조센터 내 엔지니어, 장비로 기업과 공동 개발되며 산출물(도면 등)은 기업에 귀속
- **(세부내용)** 사업비 지원이 아닌 공동개발로 일부 재료비(실비)는 선정기업 부담
 - * 하드웨어 분야의 전자보드는 샘플로 30개이며, 선정 후 협의에 따라 변경 될 수 있음

지원분야	지원항목	지원내용	비고
하드웨어 (전자보드)	전자회로개발	- 전자회로 설계, 아트웍, 부품선정 - 전자보드(PCB) 제작, 조립, 검사	신청항목 중복 선택 가능
	펌웨어개발	- 펌웨어 설계, 디버깅	
	전자 보드 제작	- 표면실장(SMT), 조립, 검사, 측정	
	실증	- 설문, 전문가 분석, 소비자 피드백, 론칭	
기구 (하우징)	3D모델링	- 외형 컨셉 단계의 3D모델링 설계 - 3D랜더링 디자인 이미지 지원	
	기구설계	- 조립, 공정, 금형, 양산성 등을 고려한 시제품 제작 전 세부 설계	
	역설계	- 3D스캐너 활용 제품 역설계	
	목업제작	- 산업용 3D프린터를 활용 목업제작 (붙임3참조)	

* 최종 지원항목은 센터 상황에 따라 변경될 수 있음

□ 추진일정

- **(평가방법)** 1차 평가위원회를 통해 선정되며, 2차 평가는 전자제조센터 내부 인프라 기반 가능 제품으로 선정

접수	1차 서류 (평가위원회)	2차 대면 (내부평가)	최종발표
2024. 1. 29 ~ 2. 19	2024. 2. 22	2024. 2. 26 ~ 2. 27	2024. 2. 29

- * (1차평가) 외부전문가로 구성, 질문 발생 시 통화에 의한 질의, 응답 예정
- * (2차평가) 제출한 서류를 기반으로 간단 인터뷰(Zoom) 진행 예정
- * 결과는 선정기업에 한하여 개별 통보되며 **우선순위에 따라 지원 일정 별도 협의**
- * 일정은 내부 사정에 따라 변경될 수 있음

□ 선정기준

평가기준	배점	상세평가항목(점)
필요성	30	- 달성하고자 하는 목표의 명확성(15) - 신청제품의 사양, 현재 상황 등 지원의 필요성(15)
혁신성	30	- 독창성 및 참신성(15) - 기술경쟁력 및 기술적 우수성(15)
타당성	40	- 지원내용, 범위, 일정의 구체성(10) - 제품화(사업화) 가능성(20) - 개발 종료 후 성과 및 목표달성 방안(10)
가산점	+10	- 서울시 소재 기업(10)

- * 평가기준에 따라 60점 이상 중, 고득점 순으로 '최종대상자' 선정
- * 가산점은 공고일(24.1.25) 이전 서울시 소재 기업으로 등록된 기업

□ 신청 및 문의

- **(신청방법)** 구비서류 작성 후 이메일 제출('24년 2월 19일 18시까지)
- **(제출서류)** ①신청 및 계획서, ②개인(기업)정보 수집·이용·제공 동의서, ③사업자 등록증, ④제품자료(해당시 제출 : 카탈로그, 2D/3D도면, 이미지 등)
 - * 기존 하드웨어 개발 관련 데이터 보유 시 회로도, 부품 데이터시트 등 제출
 - * 모델링 관련 데이터 제출 시 확장자(STL(고화질), STP, STEP) 확인하여 제출
- **(접수 및 문의)** 한국전자정보통신산업진흥회 전자제조센터/용산시제품제작소
 - * 접수: yes@gokea.org, 문의 : 070-5088-0218

□ 유의사항

- 제출서류가 요청 기한 내 미제출 또는 미비할 경우 신청 포기로 간주
- 동일 개발 내용으로 정부지원(지자체 포함) 받은 경우 중복지원으로 제외
- 채무불이행, 국세·납세 체납된 자 또는 기업의 경우 신청 제외
- 제출된 서류 및 세부사업계획서 등의 허위, 위·변조, 그 밖에 부정하게 작성된 경우 선정 취소 및 협약 해약 진행
- 제출된 서류는 일절 반환 불가
- 심사결과 미공개

붙임 1. (양식) 스마트소형전자제품 개발·제조 지원 신청 및 계획서

붙임 2. 개인(기업)정보 수집·이용·제공 동의서

붙임 3. 전자제조센터 제품화 지원 장비 사양 요약